

斯达半导体股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案调整每股分配金额
及资本公积转增股本总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配及转增比例：每股派发现金红利由人民币 1.59784 元（含税）调整为人民币 1.59760 元（含税），每 10 股以资本公积转增 4 股。
- 本次调整原因：由于公司 2021 年股票期权激励计划第二期自主行权，公司总股本发生变化。公司按照现金分配总额和每股转增比例不变的原则，相应调整每股分配金额和转增总额。

一、利润分配方案的基本情况

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 04 月 07 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和 2024 年 04 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益分派的股权登记日总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本，具体分配方案如下：

1. 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 15.9784 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 170,955,274 股，预计派发现金红利 273,159,175.01 元（含税），剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例（本年度公

司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为 30.00%。

2. 公司向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司总股本为 170,955,274 股, 本次转股后, 公司总股本为 239,337,383 股(因转增比例计算过程中涉及舍去小数取整的情况, 转增后最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的结果为准)。

如在实施权益分派股权登记日前, 因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总额和每股转增比例不变, 相应调整每股分配金额和转增总额。具体内容详见公司分别于 2024 年 04 月 08 日、04 月 30 日披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号: 2024-006)、《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-018)。

二、利润分配方案调整情况

由于公司 2021 年股票期权激励计划第二期自主行权, 自 2024 年 01 月 01 日至本公告披露日, 公司新增股份 25,366 股, 公司总股本由 170,955,274 股变更为 170,980,640 股。

依据上述总股本变动情况, 公司按照现金分配总额和每股转增比例不变的原则, 相应调整每股分配金额和转增总额, 调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本, 每股派发现金红利调整为 1.59760 元(含税), 合计拟派发现金红利 273,158,670.46 元(含税, 利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。

综上所述, 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案调整为: 每股现金红利人民币 1.59760 元(含税), 利润分配总额为人民币 273,158,670.46 元(含税, 本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致);

每 10 股以资本公积转增 4 股，则本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加 68,392,256 股，转增后的总股本为 239,372,896 股。具体以权益分派实施结果为准（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2024 年 05 月 08 日